



[kingston.com/ufs](http://kingston.com/ufs)

## UFS

### 面向移动应用和嵌入式应用的高性能存储

金士顿的通用闪存存储 (UFS) 解决方案非常适合需要在单个集成封装中实现高性能和低功耗的应用。小尺寸和低功耗使 UFS 成为嵌入式应用和移动应用的理想选择。UFS 是联合电子器件工程委员会 (JEDEC) 制定的开放标准。遵从这项标准可确保与大量主机处理器的兼容性。金士顿的 UFS 设备在一个表面封装设备中集成了 NAND 闪存非易失存储器与金士顿的 UFS 控制器。金士顿先进的 UFS 控制器提供了所有必要的算法，可以可靠地管理 NAND 闪存，同时全面实现 UFS 功能和特性。

## 主要优势

- 通过采用 MIPI Alliance M-PHY 接口标准的高速串口高速传输数据。
- 低功耗，包含省电功能，使 UFS 成为众多高性能移动应用的理想存储解决方案。
- 基于经过验证的行业标准，可确保可靠性以及与众多处理器的互操作性。
- 紧凑、小巧的尺寸使 UFS 非常适合小尺寸设计。
- 低成本、广泛可用的存储解决方案。

## 市场细分



智能手机、平板电脑、PC 和 Chromebook



虚拟现实设备与增强现实设备



高清视频、会议和监视系统

## UFS 产品型号和规格

产品型号	存储容量	描述	封装尺寸	工作温度
UFS32G-TXA7	32GB	UFS 2.1 G4 2L 153B 32GB	11.5x13x0.85	-25°C ~ +85°C
UFS64G-TXA7	64GB	UFS 2.1 G4 2L 153B 64GB	11.5x13x0.85	-25°C ~ +85°C
UFS64G-CY14	64GB	UFS 3.1 G4 4P TLC 153B 64GB	11x13x0.85	-25°C ~ +85°C
UFS128-CY14	128GB	UFS 3.1 G4 4P TLC 153B 128GB	11x13x0.85	-25°C ~ +85°C
UFS256-CY14	256GB	UFS 3.1 G4 4P TLC 153B 256GB	11x13x0.95	-25°C ~ +85°C



本文件如有变更，恕不另行通知。

©2023 Kingston Technology Far East Corp. (Asia Headquarters) No. 1-5, Li-Hsin Rd. 1, Science Park, Hsin Chu, Taiwan.

保留所有权利。所有商标和注册商标均为各所有人之财产。 MKF-959.2CN

**Kingston**  
TECHNOLOGY